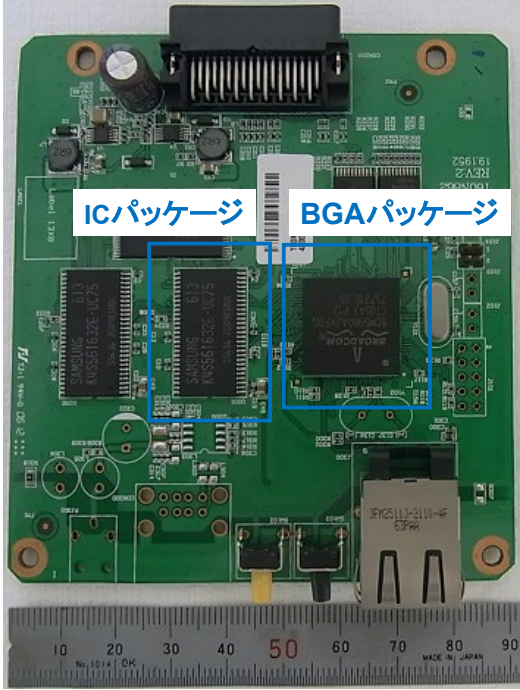
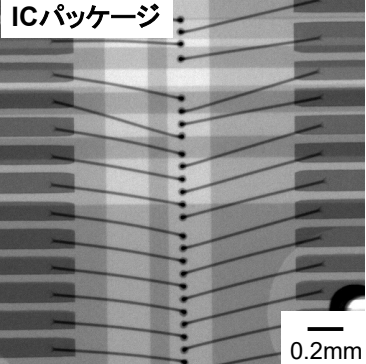
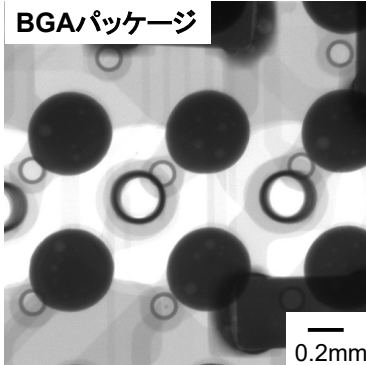



×線を用いた非破壊内部微細構造観察

※

<p>事例</p>	<p>×線を用いて実装 IC パッケージの内部構造の透視観察を行いました。</p>
<p>試験内容 と結果</p>	<p>マイクロフォーカスX線透視装置を用いて、プリント基板に実装されたICパッケージの内部の微細構造を観察しました。</p> <p>実装ICパッケージの内部にあるボンディングワイヤーやBGA(Ball Grid Array)の bumps を観察することができます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="376 533 783 584" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>プリント基板の外観</p> </div> <div data-bbox="940 533 1477 584" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>青色で囲んだ IC パッケージ内部の透視画像</p> </div> </div>   
<p>使用装置</p>	<p>マイクロフォーカス×線透視装置（令和2年度電源立地地域対策交付金）</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>メーカー名： 株式会社島津製作所 型式： SMX-1000L Plus</p> <p>【機器の概要】 X線管電圧:20～90kV (10kVステップ) X線管電流:0～250 μA (1 μAステップ) 検査可能サイズ:520mm×620mm 試料重量:最大5kg 画像分解能:5 μm 透視視野:1.7mm² ～ 35mm² X線検出器傾動:最大60度</p> </div>
<p>手数料</p>	<p>マイクロフォーカス×線透視装置試験 6,200円/時間</p>

測定物のサイズや形状、材質によってはできない場合があります。